

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：桂嫚婷

電話：03-5918009

E-mail：manting@itri.org.tw



1120016638010

110202 台北市信義路五段 5 號 3 樓 3E41 室

受文者：台灣電子設備協會

發文日期：中華民國 112 年 08 月 03 日

發文字號：工研轉字第 1120016638 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：本院擬舉辦「112 年度工研院電子與光電系統研究所半導體光源、顯示技術、軟性光電元件及其他等相關研發成果讓與案」公開招標活動，請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

- 一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦「112 年度工研院電子與光電系統研究所半導體光源、顯示技術、軟性光電元件及其他等相關研發成果讓與案」（99 案 143 件專利）之公開招標活動（讓與標的詳如附件）。
- 二、「讓與標的」共分為四個類別：
 - （一）半導體光源：49 案 72 件；
 - （二）立體影像顯示技術：21 案 30 件；
 - （三）軟性光電元件及製程：21 案 28 件；
 - （四）其他：8 案 13 件。
- 三、旨揭公開招標活動詳細資訊如下：
 - （一）本案截標日為民國（下同）112 年 8 月 28 日，開標包含初審（112 年 9 月 5 日）及複審（決標日為 112 年 9 月 19 日），投標廠商於通過初審後，始進入複審。會另行通知投標

廠商，請廠商依通知時間進行複審。

(二) 詳細投標訊息及讓與標的資料，請參考工研院研發成果公告網站：

(https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1217571523200277130)

(三) 公開說明會資訊：

1、舉辦時間：112 年 8 月 16 日 14 時舉辦。

2、舉辦地點：採取線上方式辦理。

3、報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 112 年 8 月 15 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「112 年度工研院電子與光電系統研究所半導體光源、顯示技術、軟性光電元件及其他等相關研發成果讓與案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 112 年 8 月 15 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

四、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 桂小姐

電話：(03) 591-8009

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：ManTing@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣電子設備協會

院長



依本院權責劃分規定授權業務主管決行



112 年度工研院電子與光電系統研究所 半導體光源、顯示技術、軟性光電元件及其他等 相關研發成果讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強而有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含 99 案 143 件專利（以下簡稱：「讓與標的」）。

「讓與標的」共分為：

- （一）半導體光源：49 案 72 件；
- （二）立體影像顯示技術：21 案 30 件；
- （三）軟性光電元件及製程：21 案 28 件；
- （四）其他：8 案 13 件。

「讓與標的」含共有專利，並已預先取得共有人之同意。「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同）112 年 8 月 16 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 112 年 8 月 15 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「112 年度工研院電子與光電系統研究所半導體光源、顯示技術、軟性光電元件及其他等相關研發成果讓與案：公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 112 年 8 月 15 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

（三）自本讓與案公告日起至截標日 112 年 8 月 28 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。



五、投標方法：

(一) 本讓與案採通訊或親送方式投標。

投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

1. (密封) 價格封。
2. 押標金。
3. 公司設立證明文件 (如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本)。
4. 近兩年財報資料。
5. 公司基本資料暨運用規劃說明表。
6. 商業營運計畫書一式 7 份。(若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。)

(前述全部資料文件等，以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「112 年度工研院電子與光電系統研究所半導體光源、顯示技術、軟性光電元件及其他等相關研發成果讓與案投標」，於截標日 112 年 8 月 28 日 17 時整 (含) 前 (以送達收據為憑) 掛號寄達或親送至：

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 桂小姐收。

(二) 廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表及商業營運計畫書中詳細敘明，並於公司基本資料暨運用規劃表敘明境外實施金額。

(三) 商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1. 公司背景／關係企業／合作夥伴簡介 (20%)
2. 公司財務狀況 (20%)
3. 公司營運／研發能力 (20%)
4. 「讓與標的」運用規劃 (30%)
5. 國內產業效益 (10%)

(如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等)

(四) 投標方式：本讓與案採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。

(「讓與標的」以同一發明為一案。)

(五) 本讓與案不得共同投標或重複投標。

(六) 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

(七) 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。



六、押標金：

- (一) 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
於決標當日依第八條第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起 10 個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格，但經工研院同意者，不在此限。
- (二) 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
- (三) 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

- (一) 投標時間截止後之投標。
- (二) 開標前業已公告停止本讓與案交易程序。
- (三) 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
- (四) 投標單附加任何成交條件者。
- (五) 「投標文件」之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
- (六) 「投標文件」有所缺漏者。但押標金不足或商業營運計畫書份數不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於複審前未能補足者，其投標為無效。
- (七) 投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果(包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果)轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。
- (八) 投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方式：

- (一) 分為初審(112 年 9 月 5 日)及複審(112 年 9 月 19 日)，投標廠商於通過初審後，始能進入複審。工研院會另行通知通過初審之投標廠商依通知時間進行複審。
- (二) 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。
- (三) 初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、商業營運計畫書等進行形式審查及確認。
- (四) 投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會會議就商業營運計畫書、價格等進行複審，投標廠商於複審時應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。
- (五) 投標廠商若有境外實施需求，除應依「五、投標方法」第(二)點敘明外，並應於複審時報告說明。



- (六) 複審時，工研院開標審議委員會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商價格封，將以投標金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商有一次優先加價機會，若此優先加價仍無超過底價，之後則由超過及格分之所有投標廠商同時議價，議價次數以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上超過及格分之投標廠商之投標金額均超過底價且相同，得提供該投標廠商議價機會，並以高價者得標。議價次數以三次為限，經三次議價後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。(議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書)
- (七) 開標時將請律師到場監標。
- (八) 開標結果依政府法令相關規定，須向主管機關呈報者，則於主管機關同意後始生效力。
- (九) 工研院將個別通知投標廠商開標結果(不公告得標廠商)。
- (十) 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。

九、契約事項：

- (一) 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
- (二) 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。
- (三) 得標廠商與工研院簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。
- (四) 遵守政府法令規定：得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定(包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定)。前述法令變動時，亦同。
- (五) 得標廠商應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。

- (六) 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本讓與案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。「讓與契約書」生效日：「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部及共有人同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部及共有人之意見並無影響能力。
- (七) 反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部及/或工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。
- (八) 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：
1. 工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；
 2. 工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；
 3. 工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。
- (九) 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本讓與案公告日之「讓與標的」現狀辦理本讓與案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。
- (十) 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益



繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

(十一)「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部技術處，以下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及同意後始得為之：

- 1.得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
- 2.得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
- 3.得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
- 4.得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

(十二)得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

- 1.得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
- 2.得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。
- 3.為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

(十三)得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前書面通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。此外，若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與或輾轉讓與「讓與標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與「後手」之讓與契約，否則即視為得標廠商已將「讓與標的」讓與予「NPE」或「未

經同意之受讓者」，工研院得依前述約定行使相關權利。

(十四) 得標廠商應使所有「後手」遵守本條第七項至第九項、第十一項至第十六項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

(十五) 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院並取得書面同意。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

(十六) 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

(十七) 得標廠商應盡力進行產品開發等運用「讓與標的」工作，倘得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本讓與案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本讓與案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本讓與案公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 桂小姐。

電話：(03) 591-8009。

傳真：(03) 582-0466。



工業技術研究院

Industrial Technology
Research Institute

電子信箱：ManTing@itri.org.tw。

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。



附件：專利清單

(一) 半導體光源：49 案 72 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
1	1	P51040025TW	三五族氮化物半導體元件	中華民國	獲證	TWI568014	20170121	20351006	經濟部技術處	工研院	
2	2	P51040001TW	發光元件的封裝結構	中華民國	獲證	TWI550825	20160921	20350629	經濟部技術處	工研院	
3	3	P51030027TW	光束整形發光裝置	中華民國	獲證	TWI555951	20161101	20341216	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
4	4	P51030025TW	半導體發光結構	中華民國	獲證	TWI572061	20170221	20341209	經濟部技術處	工研院	
5	5	P51030020TW	感測結構及其製作方法	中華民國	獲證	TWI564767	20170101	20350629	經濟部技術處	工研院	
6	6	P51030013TW	加工設備	中華民國	獲證	TWI595956	20170821	20350629	經濟部技術處	工研院	非專屬授權中
7	7	P51030007TW	發光模組及應用其之光照系統	中華民國	獲證	TWI589326	20170701	20340828	經濟部技術處	工研院	
8	8	P51020061TW	時間多工之掃描裝置及立體顯示裝置	中華民國	獲證	TWI514850	20151221	20331202	經濟部技術處	工研院	
9	9	P51020052US	捲曲玻璃基板之間隔元件	美國	獲證	US9359161	20160607	20340803	經濟部技術處	工研院	
9	10	P51020052TW	捲曲玻璃基板之間隔元件	中華民國	獲證	TWI481578	20150421	20331219	經濟部技術處	工研院	
10	11	P51020038TW	發光二極體裝置	中華民國	獲證	TWI531095	20160421	20340617	工研院	工研院	曾非專屬授權
11	12	P51010169TW	發光二極體晶圓及其製造方法	中華民國	獲證	TWI513051	20151211	20330507	經濟部技術處	工研院	
12	13	P51010151TW	發光二極體元件與發光二極體元件的製造方法	中華民國	獲證	TWI497771	20150821	20330409	經濟部技術處	工研院	
13	14	P51010149US	傳送裝置	美國	獲證	US8857600	20141014	20330407	經濟部技術處	工研院	非專屬授權中
14	15	P51010148US	立體顯示系統	美國	獲證	US8939585	20150127	20330920	經濟部技術處	工研院	
14	16	P51010148CN	立體顯示系統	中國大陸	獲證	CN103913942	20170301	20330226	經濟部技術處	工研院	
15	17	P51010138US	彎曲應力的測試方法及其測試裝置	美國	獲證	US9157843	20151013	20330628	經濟部技術處	工研院	
15	18	P51010138TW	彎曲應力的測試方法及其測試裝置	中華民國	獲證	TWI480549	20150411	20321220	經濟部技術處	工研院	
16	19	P51010136TW	傳輸裝置	中華民國	獲證	TWI541185	20160711	20321223	經濟部技術處	工研院	
16	20	P51010136CN	傳輸裝置	中國大陸	獲證	CN103787119	20161228	20330421	經濟部技術處	工研院	
17	21	P51010134TW	光電元件封裝體	中華民國	獲證	TWI562411	20161211	20321129	經濟部技術處	工研院	
18	22	P51010120TW C1	影像互動系統、手指位置的偵測方法、立體顯示系統以及立體顯示器的控制方法	中華民國	獲證	TWI516093	20160101	20330516	經濟部技術處	工研院	
19	23	P51010116TW	多光耦合裝置	中華民國	獲證	TWI486144	20150601	20321225	經濟部技術處	工研院	
20	24	P51010112TW	噴氣系統及氣相磊晶設備	中華民國	獲證	TWI480414	20150411	20321113	經濟部技術處	工研院	
21	25	P51010107TW	薄膜發光二極體裝置	中華民國	獲證	TWI479652	20150401	20321223	經濟部技術處	工研院	
22	26	P51010103US	可撓式超音波致動裝置	美國	獲證	US9132263	20150915	20331229	經濟部技術處	工研院	
23	27	P51010101TW	觸控結構及其製造方法	中華民國	獲證	TWI494801	20150801	20321129	經濟部技術處	工研院	



工業技術研究院

Industrial Technology
Research Institute

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
24	28	P51010100US	觸控結構及其製造方法	美國	獲證	US9052789	20150609	20340128	經濟部技術處	工研院	
24	29	P51010100TW	觸控結構及其製造方法	中華民國	獲證	TWI522855	20160221	20321107	經濟部技術處	工研院	
24	30	P51010100CN	觸控結構及其製造方法	中國大陸	獲證	CN103809798	20170301	20321210	經濟部技術處	工研院	
25	31	P51010050TW	發光二極體結構、發光二極體封裝與發光二極體結構之溫度的量測方法	中華民國	獲證	TWI482310	20150421	20321212	經濟部能源局	工研院	
26	32	P51010031US	用於檢測半導體元件之熱性與電性之間的關係的方法及設備	美國	獲證	US9110125	20150818	20330710	經濟部技術處	工研院	非專屬授權中
26	33	P51010031TW	用於檢測半導體元件之熱性與電性之間的關係的方法及設備	中華民國	獲證	TWI482233	20150421	20320813	經濟部技術處	工研院	非專屬授權中
27	34	P51010023US	多視角視差圖的補洞方法	美國	獲證	US9076249	20150707	20340225	經濟部技術處	工研院	
27	35	P51010023TW	多視角視差圖的補洞方法	中華民國	獲證	TWI547904	20160901	20320905	經濟部技術處	工研院	
27	36	P51010023CN	多視角視差圖的補洞方法	中國大陸	獲證	CN103458257	20150527	20330122	經濟部技術處	工研院	
28	37	P51010015US	影像處理裝置及影像處理方法	美國	獲證	US8934707	20150113	20330407	經濟部技術處	工研院	
28	38	P51010015TW	影像處理裝置及影像處理方法	中華民國	獲證	TWI473038	20150211	20320829	經濟部技術處	工研院	
29	39	P51010003TW	玻璃傳輸結構	中華民國	獲證	TWI422543	20140111	20320712	經濟部技術處	工研院	非專屬授權中
30	40	P51000167US	面光源以及可撓性面光源	美國	獲證	US8915634	20141223	20320824	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
30	41	P51000167TW	面光源以及可撓性面光源	中華民國	獲證	TWI497016	20150821	20320418	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
30	42	P51000167CN	面光源以及可撓性面光源	中國大陸	獲證	CN103133918	20151111	20320808	經濟部技術處	工研院	
31	43	P51000164US	發光二極體光源	美國	獲證	US8764231	20140701	20321125	經濟部技術處	工研院	
32	44	P51000161US	照明裝置、光源結構與光源模組	美國	獲證	US8764228	20140701	20321224	經濟部技術處	工研院	
32	45	P51000161TW	照明裝置、光源結構與光源模組	中華民國	獲證	TWI465667	20141221	20320301	經濟部技術處	工研院	
33	46	P51000152US	控制光伏裝置交流輸出的方法與交流光伏裝置	美國	獲證	US9148021	20150929	20340517	經濟部技術處	工研院	
34	47	P51000143TW	非接觸式操控之立體影像顯示裝置	中華民國	獲證	TWI520571	20160201	20320411	經濟部技術處	工研院	
35	48	P51000140TW	內埋式螢光柱聚光板、其形成方法及太陽能電池模組	中華民國	獲證	TWI469378	20150111	20311229	經濟部技術處	工研院	非專屬授權中
35	49	P51000140CN	染料標示型高分子、聚光板及其形成方法、太陽能電池模組及免插電燈具	中國大陸	獲證	CN103183971	20160803	20321226	經濟部技術處	工研院	
36	50	P51000134US	模組化照明裝置與光源模組	美國	獲證	US8814418	20140826	20330113	經濟部技術處	工研院	
36	51	P51000134TW	模組化照明裝置與光源模組	中華民國	獲證	TWI465666	20141221	20320109	經濟部技術處	工研院	
37	52	P51000123US	壓力感測器的電性量測裝置及其方法	美國	獲證	US8776607	20140715	20321110	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
38	53	P51000111TW	發光晶片及發光晶片的製造方法	中華民國	獲證	TWI467819	20150101	20311222	經濟部技術處	工研院	



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
38	54	P51000111CN	發光晶片及發光晶片的製造方法	中國大陸	獲證	CN103178200	20151104	20320223	經濟部技術處	工研院	
39	55	P51000104TW	立體互動影像之處理方法及系統	中華民國	獲證	TW1471799	20150201	20311229	經濟部技術處	工研院	
40	56	P51000098TW	發光二極體封裝結構	中華民國	獲證	TW1514630	20151221	20311229	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
41	57	P51000096US	半導體光源裝置	美國	獲證	US8979313	20150317	20330711	經濟部技術處	工研院	
41	58	P51000096TW	半導體光源裝置	中華民國	獲證	TW1471505	20150201	20311228	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
42	59	P51000070US	顯示裝置	美國	獲證	US8878780	20141104	20330418	經濟部技術處	工研院	
43	60	P51000062US	混合多工式立體顯示器及混合多工式立體影像之顯示方法	美國	獲證	US9116357	20150825	20280828	經濟部技術處	工研院	
43	61	P51000062TW	混合多工式立體顯示器及混合多工式立體影像之顯示方法	中華民國	獲證	TW1471607	20150201	20320328	經濟部技術處	工研院	
43	62	P51000062CN	混合多工式立體顯示器及其顯示方法	中國大陸	獲證	CN103176277	20160120	20320530	經濟部技術處	工研院	
44	63	P51000055US	資料處理方法及其裝置	美國	獲證	US9147021	20150929	20340508	經濟部技術處	工研院	
44	64	P51000055CN	資料處理方法及其裝置	中國大陸	獲證	CN103123617	20160113	20320104	經濟部技術處	工研院	
45	65	P51000045US	照明裝置及其組裝方法	美國	獲證	US8926130	20150106	20320823	經濟部技術處	工研院	非專屬授權中
45	66	P51000045TW A1	發光二極體燈具	中華民國	獲證	D156274	20131001	20270830	經濟部技術處	工研院	
45	67	P51000045TW	照明裝置及其組裝方法	中華民國	獲證	TW1468621	20150111	20320301	經濟部技術處	工研院	非專屬授權中
46	68	P51000030US	一種單基板太陽能電池模組結構	美國	獲證	US9076900	20150707	20340506	經濟部技術處	工研院	
47	69	P51000029TW	從單鏡頭影像呈現立體影像的方法與影像擷取系統	中華民國	獲證	TW1463243	20141201	20311227	工研院	工研院	曾非專屬授權
48	70	P51000020TW	軟性基板結構及其製造方法	中華民國	獲證	TW1424797	20140121	20310831	經濟部技術處	工研院	
49	71	P51000012TW	照明裝置	中華民國	獲證	TW1422784	20140111	20310811	經濟部技術處	工研院	
49	72	P51000012CN	照明裝置	中國大陸	獲證	CN102927462	20141126	20310908	經濟部技術處	工研院	

(二) 立體影像顯示技術：21 案 30 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
50	73	P61000053TW	半導體元件及其製造方法	中華民國	獲證	TW1463663	20141201	20311229	經濟部技術處	工研院：創智智權	曾非專屬授權
50	74	P61000053CN	互補式金屬氧化物半導體元件及其製造方法	中國大陸	獲證	CN103187417	20160113	20320307	經濟部技術處	工研院：創智智權	
51	75	P61000003TW	觸控裝置及觸控面板	中華民國	獲證	TW1450149	20140821	20311214	經濟部技術處	工研院：創智智權	
52	76	P51990136US	相位差膜與立體顯示裝置的製作方法及相位差膜	美國	獲證	US8797483	20140805	20310921	工研院	工研院	非專屬授權中
53	77	P51990126TW C1	具有多種光形輸出的發光二極體的燈具光源	中華民國	獲證	TW1504015	20151011	20320402	經濟部技術處	工研院	



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
53	78	P51990126CN	具有多種光形輸出的發光二極管的燈具光源	中國大陸	獲證	CN102829416	20150722	20311228	經濟部技術處	工研院	非專屬授權中
54	79	P51990086TW	堆疊電極以及光電元件	中華民國	獲證	TWI520354	20160201	20301215	經濟部技術處	工研院	
55	80	P51990069CN	立體顯示器	中國大陸	獲證	CN102346307	20140409	20310718	經濟部技術處	工研院	
56	81	P51990043US C1	修補三維立體影像之裝置及方法	美國	獲證	US9865083	20180109	20320707	經濟部技術處	工研院	
56	82	P51990043TW	修補三維立體影像之裝置及方法	中華民國	獲證	TWI492186	20150711	20301102	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
57	83	P51990039TW	具有立體影像攝影引導的攝影系統與方法及自動調整方法	中華民國	獲證	TWI433530	20140401	20301031	經濟部技術處	工研院	
58	84	P51990036US	由單視域內視鏡影像產生立體視野影像之方法與系統，及其電腦程式產品	美國	獲證	US9066086	20150623	20310608	經濟部技術處	工研院	
59	85	P51990035TW C1	光色調制方法、發光二極體光源模組及其封裝結構	中華民國	獲證	TWI452670	20140911	20310123	經濟部技術處	工研院	
59	86	P51990035CN	光色調制方法及發光二極管光源模塊	中國大陸	獲證	CN102458019	20140122	20301228	經濟部技術處	工研院	
60	87	P51980148US A3	發光二極體晶片、包含其之封裝結構以及其製造方法	美國	獲證	US8759865	20140624	20310802	經濟部技術處	工研院	
60	88	P51980148TW	發光二極體晶片、包含其之封裝結構以及其製造方法	中華民國	獲證	TWI422065	20140101	20301230	經濟部技術處	工研院	非專屬授權中
60	89	P51980148CN A1	發光二極管晶片、發光二極管封裝結構、及其形成方法	中國大陸	獲證	CN103180979	20160803	20310802	經濟部技術處	工研院	
60	90	P51980148CN	發光二極管晶片、發光二極管封裝結構、及用以形成上述的方法	中國大陸	獲證	CN103222073	20170329	20300802	經濟部技術處	工研院	
61	91	P51980146TW	照明裝置	中華民國	獲證	TWI402456	20130721	20300316	經濟部技術處	工研院	
62	92	P51980140CN	背光模塊、面光源模塊及導光網格結構	中國大陸	獲證	CN102261602	20131009	20300527	經濟部技術處	工研院	
63	93	P51980137TW	具有散熱結構之平面式揚聲器裝置以及平面揚聲器之散熱方法	中華民國	獲證	TWI469651	20150111	20300307	經濟部技術處	工研院	
64	94	P51980095US	一種利用影像資訊進行場景分類的方法	美國	獲證	US8693769	20140408	20310720	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
65	95	P51980083TW C1	發光二極體封裝界面之檢測裝置及方法	中華民國	獲證	TWI469236	20150111	20301208	經濟部能源局	工研院	
65	96	P51980083CN C1	發光二極管封裝接口的檢測裝置及方法	中國大陸	獲證	CN102183546	20141224	20310113	經濟部能源局	工研院	
66	97	P51980080TW	產生立體影像之影像深度的方法	中華民國	獲證	TWI398158	20130601	20291130	經濟部技術處	工研院	
67	98	P51980055US	一種可以撓曲的太陽能電池及其裝置	美國	獲證	US8937242	20150120	20330213	經濟部技術處	工研院	



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
68	99	P51980037US	由單眼圖像產生深度圖的方法及其系統	美國	獲證	US9030469	20150512	20310221	經濟部技術處	工研院	
69	100	P51980005TW	發光裝置	中華民國	獲證	TWI478374	20150321	20290507	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
69	101	P51980005CN	發光裝置	中國大陸	獲證	CN101577306	20120104	20290507	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
70	102	P51970138TW	座椅系統	中華民國	獲證	TWI377926	20121201	20290312	經濟部技術處	工研院	

(三) 軟性光電元件及製程：21 案 28 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
71	103	P51970130TW	LED 光源裝置及其出光方法	中華民國	獲證	TWI412784	20131021	20290823	經濟部技術處	工研院	
71	104	P51970130CN	一種光色調制方法及光色可變的發光二極管光源模塊	中國大陸	獲證	CN102036435	20140430	20290927	經濟部技術處	工研院	
72	105	P51970088TW	發光二極體晶片及其製作方法	中華民國	獲證	TWI446571	20140721	20281013	經濟部技術處	工研院	
73	106	P51970087TW	磁性發光元件	中華民國	獲證	TWI412156	20131011	20281210	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
73	107	P51970087KR	磁性發光元件	韓國	獲證	KR101200874	20121107	20281225	經濟部技術處	工研院	
73	108	P51970087JP D1	磁性發光元件	日本	獲證	JP5564129	20140620	20281225	經濟部技術處	工研院	
73	109	P51970087CN D1	發光裝置	中國大陸	獲證	CN103208569	20151104	20281225	經濟部技術處	工研院	
74	110	P51970085TW	光波導結構及其製造方法	中華民國	獲證	TWI393928	20130421	20281118	經濟部技術處	工研院	
75	111	P51970062TW C1	發光二極體之 PN 接面溫度的測試方法	中華民國	獲證	TWI404923	20130811	20281201	經濟部技術處	工研院	
76	112	P51970058TW	磁性發光裝置	中華民國	獲證	TWI464901	20141211	20290624	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
77	113	P51970036TW	三色膽固醇液晶之數位式資料電壓驅動電路及其方法	中華民國	獲證	TWI398844	20130611	20280625	經濟部技術處	工研院	
78	114	P51970022TW	發光裝置	中華民國	獲證	TWI469384	20150111	20290505	工研院	工研院	
79	115	P51960163TW	全像資料頁的編碼偵測方法及裝置	中華民國	獲證	TWI375951	20121101	20280907	經濟部技術處	工研院	
80	116	P51960131TW D1	充電裝置	中華民國	獲證	TWI489731	20150621	20280113	工研院	工研院	
81	117	P51960105TW	發光二極體壽命試驗裝置及方法	中華民國	獲證	TWI345067	20110711	20271122	經濟部能源局	工研院	
81	118	P51960105CN	發光二極管壽命試驗裝置及方法	中國大陸	獲證	CN101452044	20110126	20271206	經濟部能源局	工研院	
82	119	P51960067TW	可撓式揚聲器結構	中華民國	獲證	TWI406573	20130821	20270904	經濟部技術處	工研院	曾非專屬授權
83	120	P51960039TW	光電混載電路板及其製造方法	中華民國	獲證	TWI393509	20130411	20270703	經濟部技術處	工研院	
84	121	P51960015US	混合多工式立體顯示器及其顯示方法	美國	獲證	US8724039	20140513	20310930	經濟部技術處	工研院	
84	122	P51960015TW	混合多工式立體顯示器及其顯示方法	中華民國	獲證	TWI347453	20110821	20270622	經濟部技術處	工研院	
85	123	P51950116TW	多波長量子點雷射元件	中華民國	獲證	TWI364892	20120521	20270109	經濟部技術處	工研院	



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
86	124	P51050079TW	發光裝置	中華民國	獲證	M541585	20170511	20270207	經濟部技術處	工研院	
87	125	P51050078TW	照明裝置	中華民國	獲證	TWI603035	20171021	20370209	經濟部技術處	工研院	
88	126	P51050003TW	容器之部分	中華民國	獲證	D179237	20161101	20310330	經濟部技術處	工研院	
89	127	P51040057TW	凹版印刷裝置	中華民國	獲證	TWI574846	20170321	20360217	經濟部技術處	工研院	
89	128	P51040057JP	凹版印刷裝置	日本	獲證	JP6207668	20170915	20360515	經濟部技術處	工研院	
90	129	P51040053TW	立體列印系統	中華民國	獲證	TWI566918	20170121	20351202	經濟部技術處	工研院	
91	130	P51040046TW	發光裝置	中華民國	獲證	TWI579504	20170421	20351118	經濟部技術處	工研院	

(四) 其他 (TFT/LCD) : 8 案 13 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
92	131	P61990068TW	彩色濾光片與影像感測器	中華民國	獲證	TWI434404	20140411	20301206	經濟部技術處	工研院	
93	132	P61990050TW C1	用以感測施力之感測裝置	中華民國	獲證	TWI461668	20141121	20310823	經濟部技術處	工研院; 創智智權	
94	133	P61990027US	軟性顯示面板及其組裝方法	美國	獲證	US9230467	20160105	20330331	工研院	工研院; 創智智權	
94	134	P61990027TW	軟性顯示面板及其組裝方法	中華民國	獲證	TWI476738	20150311	20300906	工研院	工研院; 創智智權	
94	135	P61990027CN	軟性顯示面板及其組裝方法	中國大陸	獲證	CN102446926	20140903	20301007	工研院	工研院; 創智智權	
95	136	P61990024TW	顯示裝置	中華民國	獲證	TWI424243	20140121	20300815	經濟部技術處	工研院	
95	137	P61990024CN	顯示裝置	中國大陸	獲證	CN102385211	20140101	20300831	經濟部技術處	工研院	
96	138	P61980059US	電晶體及其製造方法	美國	獲證	US8928046	20150106	20310323	經濟部技術處	工研院; 創智智權	
96	139	P61980059TW	電晶體及其製造方法	中華民國	獲證	TWI443829	20140701	20300415	經濟部技術處	工研院; 創智智權	曾非專屬授權
97	140	P61980005TW	主動層堆疊結構及其製造方法及其應用	中華民國	獲證	TWI419328	20131211	20290611	經濟部技術處	工研院; 創智智權	曾非專屬授權
98	141	P61970075US	觸控式顯示裝置及其製造方法	美國	獲證	US8723413	20140513	20330314	經濟部技術處	工研院; 創智智權	
98	142	P61970075TW	觸控式顯示裝置及其製造方法	中華民國	獲證	TWI463452	20141201	20290420	經濟部技術處	工研院; 創智智權	
99	143	P61010048TW	半導體元件結構及其製造方法	中華民國	獲證	TWI508171	20151111	20330204	經濟部技術處	工研院; 創智智權	

【備註】本讓與案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。